



2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年8月12日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス
 コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186
 四半期報告書提出予定日 2022年8月12日 配当支払開始予定日 ー
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨)

1. 2023年3月期第1四半期の連結業績 (2022年4月1日～2022年6月30日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第1四半期	43,386	56.9	7,791	62.1	10,204	57.1	7,355	△18.9
2022年3月期第1四半期	27,659	34.8	4,805	207.9	6,496	—	9,073	—

(注) 包括利益 2023年3月期第1四半期 16,610百万円 (26.0%) 2022年3月期第1四半期 13,177百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第1四半期	164.78	156.90
2022年3月期第1四半期	243.71	219.71

(注) 2022年3月期第3四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2022年3月期第1四半期に係る各数値について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年3月期第1四半期	315,282	197,378	48.9	3,393.73
2022年3月期	264,772	160,957	49.5	2,940.93

(参考) 自己資本 2023年3月期第1四半期 154,209百万円 2022年3月期 131,022百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期	—	23.00	—	27.00	50.00
2023年3月期	—	—	—	—	—
2023年3月期 (予想)	—	35.00	—	35.00	70.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

2022年3月期第2四半期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭
 2022年3月期期末配当金の内訳 普通配当 18円00銭 特別配当 9円00銭

3. 2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）

（%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	90,000	50.4	16,000	49.1	19,000	52.1	12,000	△30.5	266.37
通期	195,000	45.7	32,500	43.8	34,000	30.8	20,000	△25.0	440.15

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ー社（社名）ー、除外 ー社（社名）ー

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 有
- ② ①以外の会計方針の変更： 無
- ③ 会計上の見積りの変更： 無
- ④ 修正再表示： 無

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2023年3月期1Q	45,533,630株	2022年3月期	44,645,431株
② 期末自己株式数	2023年3月期1Q	94,096株	2022年3月期	93,897株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2023年3月期1Q	44,641,863株	2022年3月期1Q	37,230,069株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における経営環境については、2022年2月から勃発したロシアのウクライナ侵攻、中国で主に4月以降新型コロナまん延防止のための政府が取ったロックダウン措置とそれらに伴う様々な混乱が経済に大きな影響を及ぼしました。また、欧米諸国を中心にポストコロナに向け徐々に正常化の動きが加速するなか、金融緩和に伴うインフレを抑制するために政策金利の引き上げが発表されました。日本も3月の新型コロナまん延防止措置解除以降、経済正常化の方向へ進む一方、製造業は資材価格高騰の影響を受けている状況です。

為替相場は、4月以降円安が加速しました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、リモートワークやWEB会議の普及が進んだこともあり、データセンターや通信向けの需要は高水準であり、半導体製造装置の需要も伸びを継続しております。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や半導体製造プロセスに使用される各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）など各製品で販売を大きく伸ばしました。

電子デバイス事業では、サーモモジュールが通信や半導体関連などで販売は好調でした。パワー半導体用基板は、中国でのEV（電気自動車）向けの販売を大きく伸ばしました。

なお、経常利益は営業外損益で為替差益が22億円発生したこともあり、前年同期比で大きく増加しました。一方、前年同期は持分法適用会社の第三者割当増資に伴う53億円の持分変動利益（特別利益）を計上したため、相対的に当第1四半期連結累計期間は特別利益が減少しております。

この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は43,386百万円（前年同期比56.9%増）、営業利益は7,791百万円（前年同期比62.1%増）、経常利益は10,204百万円（前年同期比57.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は7,355百万円（前年同期比18.9%減）となりました。

当第1四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

なお、当第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。以下の前年同期比較については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載しております。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

世界的にもリモートワークやWEB会議の普及が進みデータセンターや通信向けの需要は高水準で推移しております。半導体関連の製造拠点や増産体制づくりは継続し、製造装置の需要が増加しました。当社の真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品は各製造装置向けに大きく売上を伸ばしました。

当社グループが供給する半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）は、設備投資の伸びに加え、デバイスメーカーの高水準な設備稼働率を背景とした半導体製造装置メーカーの旺盛な需要を取り込み、売上を大きく伸ばしました。また、他の製品では、工場稼働率との連動性が高い部品洗浄サービスなども順調に販売を伸ばしました。

この結果、当該事業の売上高は29,717百万円（前年同期比61.5%増）、営業利益は5,524百万円（前年同期比76.1%増）となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

主力のサーモモジュールは、自動車温調シート向けは弱含んだものの5G用の移動通信システム機器向けや半導体分野向け、医療分野向けの販売を伸ばしました。

パワー半導体用基板は、中国市場でのEV車載向けのAMB基板が生産能力増強も奏功し販売を大きく伸ばすことができました。DCB基板の販売もIGBT向けで順調に伸びており、全体でも大きく売り上げを伸ばしました。

この結果、当該事業の売上高は8,348百万円（前年同期比51.7%増）、営業利益は2,212百万円（前年同期比43.7%増）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

当該事業の売上高は5,320百万円（前年同期比41.7%増）、営業利益は179百万円（前年同期比1.8%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第1四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ50,510百万円増加し、315,282百万円となりました。これは主に現金及び預金19,160百万円、受取手形、売掛金及び契約資産4,959百万円、有形固定資産16,753百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第1四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ14,089百万円増加し、117,904百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金3,629百万円、短期借入金4,882百万円、長期借入金3,383百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ36,420百万円増加し、197,378百万円となりました。これは主に資本剰余金10,333百万円、利益剰余金6,153百万円、非支配株主持分13,235百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年5月16日の「2022年3月期決算短信」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	52,579	71,739
受取手形、売掛金及び契約資産	41,797	46,756
商品及び製品	7,858	8,574
仕掛品	7,882	9,351
原材料及び貯蔵品	12,696	16,268
その他	11,110	11,682
貸倒引当金	△509	△565
流動資産合計	133,414	163,807
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	22,728	26,016
機械装置及び運搬具（純額）	25,122	28,129
工具、器具及び備品（純額）	5,324	5,735
土地	1,895	1,898
リース資産（純額）	4,040	5,526
建設仮勘定	24,972	33,530
有形固定資産合計	84,083	100,837
無形固定資産		
のれん	283	273
その他	1,713	1,645
無形固定資産合計	1,996	1,918
投資その他の資産		
関係会社株式	36,058	39,087
その他	9,842	10,294
貸倒引当金	△623	△662
投資その他の資産合計	45,277	48,719
固定資産合計	131,358	151,475
資産合計	264,772	315,282

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	26,702	30,332
電子記録債務	4,068	3,623
短期借入金	6,324	11,207
1年内償還予定の社債	2,658	2,658
1年内返済予定の長期借入金	5,843	6,346
未払法人税等	2,207	2,432
賞与引当金	1,556	1,702
その他	19,437	20,798
流動負債合計	68,800	79,100
固定負債		
社債	8,806	8,581
転換社債型新株予約権付社債	2,134	1,295
長期借入金	11,796	15,180
退職給付に係る負債	560	569
資産除去債務	213	220
その他	11,503	12,956
固定負債合計	35,014	38,804
負債合計	103,814	117,904
純資産の部		
株主資本		
資本金	28,210	28,631
資本剰余金	46,071	56,404
利益剰余金	43,317	49,470
自己株式	△87	△88
株主資本合計	117,511	134,418
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	406	257
為替換算調整勘定	13,128	19,548
退職給付に係る調整累計額	△23	△14
その他の包括利益累計額合計	13,511	19,790
新株予約権	45	44
非支配株主持分	29,888	43,123
純資産合計	160,957	197,378
負債純資産合計	264,772	315,282

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
売上高	27,659	43,386
売上原価	17,290	27,694
売上総利益	10,368	15,691
販売費及び一般管理費	5,563	7,900
営業利益	4,805	7,791
営業外収益		
受取利息	103	306
補助金収入	152	220
持分法による投資利益	226	—
為替差益	1,411	2,198
その他	46	162
営業外収益合計	1,940	2,887
営業外費用		
支払利息	184	196
持分法による投資損失	—	195
その他	65	82
営業外費用合計	249	475
経常利益	6,496	10,204
特別利益		
固定資産売却益	12	—
持分変動利益	5,320	314
特別利益合計	5,332	314
特別損失		
固定資産処分損	67	86
事業撤退損	921	—
その他	106	—
特別損失合計	1,096	86
税金等調整前四半期純利益	10,732	10,431
法人税等	1,594	2,426
四半期純利益	9,138	8,005
非支配株主に帰属する四半期純利益	64	649
親会社株主に帰属する四半期純利益	9,073	7,355

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
四半期純利益	9,138	8,005
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5	△149
為替換算調整勘定	2,767	6,483
退職給付に係る調整額	4	4
持分法適用会社に対する持分相当額	1,272	2,265
その他の包括利益合計	4,039	8,604
四半期包括利益	13,177	16,610
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	12,450	13,635
非支配株主に係る四半期包括利益	726	2,974

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第1四半期連結累計期間において、主に連結子会社である江蘇富樂華半導体科技股份有限公司及び寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司が第三者割当増資を実施したため、資本剰余金が9,939百万円増加しました。

この結果、当第1四半期連結会計期間末において資本剰余金が56,404百万円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	18,402	5,502	23,904	3,754	27,659	—	27,659
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	18,402	5,502	23,904	3,754	27,659	—	27,659
セグメント利益	3,137	1,539	4,677	182	4,859	△54	4,805

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△54百万円には、セグメント間取引の消去△33百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用87百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「半導体等装置関連事業」セグメントにおいて、減損損失256百万円を計上しており、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	29,717	8,348	38,066	5,320	43,386	—	43,386
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	29,717	8,348	38,066	5,320	43,386	—	43,386
セグメント利益	5,524	2,212	7,737	179	7,916	△125	7,791

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△125百万円には、セグメント間取引の消去△131百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用256百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間より、従来「その他」に含めていた米国子会社における受託製造事業及び成膜装置事業は、経営管理区分の見直しにより「半導体等装置関連事業」の区分に含めて記載する方法に変更しております。

なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。

(重要な後発事象)

(株式取得による持分法適用関連会社の連結子会社化)

当社は、東洋刃物株式会社（以下「東洋刃物」という。）の普通株式について金融商品取引法に定める公開買付け（以下「本公開買付け」という。）を実施いたしました。本公開買付けの結果、2022年7月25日付で当社の連結子会社となりました。

なお、当社は、対象者を当社の完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けにおいて対象者株式の全て（但し、対象者が所有する自己株式を除く）を取得できなかったことから、対象者の株主を当社のみとするため、一連の手続き（株式売渡請求）により対象者の発行済株式の全てを取得する予定であります。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 東洋刃物株式会社

事業の内容 機械刃物及び機械・部品の製造、販売並びに緑化造園

(2) 企業結合を行った主な理由

当社が東洋刃物を完全子会社化することにより、一層連携を深め、グローバルネットワーク（顧客・調達網）の活用等によるコスト削減、人事交流の活発化による人材の有効活用等、生産性改善、製品ラインアップの拡充、グループファイナンス活用による財務基盤強化及び調達コストの削減、上場維持コスト等の負担軽減といったシナジー効果を発現させることを目的としております。

(3) 企業結合日

2022年7月25日（株式取得日）

2022年7月1日（みなし取得日）

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とした株式の取得

(5) 結合後企業の名称

変更ありません。

(6) 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率 33.2%

企業結合日に追加取得した議決権比率 57.8%

取得後の議決権比率 91.0%

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

企業結合日直前に保有していた持分の企業結合日における時価	1,072百万円
企業結合日に追加取得した普通株式の対価	1,868百万円
取得原価	2,940百万円

3. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差益 204百万円

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

(株式取得による持分法適用関連会社の連結子会社化)

当社は、株式会社大泉製作所（以下「大泉製作所」という。）の普通株式について金融商品取引法に定める公開買付け（以下「本公開買付け」という。）を実施いたしました。本公開買付けの結果、2022年8月1日付で当社の連結子会社となりました。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社大泉製作所

事業の内容 半導体セラミックスのサーミスタを利用した各種電子部品・温度センサの製造・販売

(2) 企業結合を行った主な理由

当社が大泉製作所を連結子会社化することにより、当社から大泉製作所に対してより積極的な協力を図れる体制とし、柔軟かつ強固な連携を構築し、経営資源の相互活用・人材交流等において密接かつ迅速な意思疎通を図ることで、早期に具体的な成果やシナジー効果を発現させることを目的としております。

(3) 企業結合日

2022年8月1日（株式取得日）

2022年7月1日（みなし取得日）

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とした株式の取得

(5) 結合後企業の名称

変更ありません。

(6) 取得した議決権比率

企業結合直前に所有していた議決権比率 34.7%

企業結合日に追加取得した議決権比率 16.3%

取得後の議決権比率 51.0%

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

企業結合日直前に保有していた持分の企業結合日における時価	3,368百万円
企業結合日に追加取得した普通株式の対価	1,964百万円
取得原価	5,332百万円

3. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

段階取得に係る差損 702百万円

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

(重要な設備投資)

当社は、2022年7月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である江蘇富樂華半導体科技股份有限公司において新工場建設を行うことを決議いたしました。

1. 設備投資の目的

パワー半導体市場の急速な拡大を背景に、今後の更なる需要拡大が見込まれます。当社は、需要増加に対応するため、これまで上海市及び江蘇省東台市の工場において生産体制の強化をまいりましたが、更なる生産能力の増強を図るため、新たな生産拠点として四川省内江市に新工場を建設し、成長著しいパワー半導体市場の需要を取り込み事業拡大が可能であると判断いたしました。

2. 設備投資の内容

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (1) 所在地 | 中国四川省内江市内経済技術開発区内 |
| (2) 事業内容 | パワー半導体用基板の製造、販売 |
| (3) 設備の内容 | 工場（建屋総床面積 約80,000㎡） |
| (4) 投資金額 | 832百万人民元（約170億円） |
| | 内訳：工場建屋 368百万人民元（約75億円） |
| | 機械設備 464百万人民元（約95億円） |
| (5) 設備の導入時期（予定） | |
| 建設工事着工 | 2022年7月 |
| 建屋等完成 | 2023年6月 |
| 機械設備設置 | 2023年12月 |
| 操業開始 | 2024年1月 |

3. 当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響

新工場の操業開始は2023年度を予定しているため、2023年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。